



斯柏森有限公司 Suprexant Co., Ltd.

Tel:886-3-369 8923

Fax:886-3-369 0927

E-mail: tylhpx@gmail.com

環氧樹脂及電子業用無鹵阻燃劑 HPX-360

無鹵阻燃劑 HPX-360 For PCB FCCL 灌注 封裝

簡介

HPX-360 是磷系的新型高效阻燃劑,白色粉末,粒徑小,磷含量高,吸水率低,在各種熱塑性和熱固性聚合物樹脂中分散性能優異,相容性好,不析出。

HPX-360 具有優秀的熱穩定性能,對材料的玻璃化轉變溫度(Tg)影響較低,不溶於水及普通有機溶劑,抗水解性佳,該阻燃劑對改善材料的介電性能及 CTI 效果很好。

規格

Characteristics	Unit	Target Value	Test Method
Phosphorus	%(w/w)	23.3 - 24.0	
Water / Moisture	%(w/w)	max. 0.5	Thermogravimetry 130°C; (11/03)
Density	g/cm ³	1.35	at 20 °C
Bulk Density	kg/m ³	100 - 250	
Decomposition Temperature	°C	> 350	
Particle Size Distribution	D50	< 2.3	Laser diffraction in acetone; (11/47)
	D95	< 10	

應用

HPX-360 無鹵阻燃劑適用於環氧樹脂及電子材料,如電器,電子用功能膠黏劑、電子標籤、阻燃油墨、環氧樹脂電子灌封膠、標籤膠等,能滿足嚴格的阻燃要求。

HPX-360 特別適用於對電氣性能及熱穩定性有較高要求的超薄型可撓性覆銅板(FCCL)、FFC 絕緣膜、FFC 補強板及環氧樹脂覆銅板(CCL)等高階應用材料。

針對覆銅板行業,HPX-360 主要是用於有 RoHS, REACH 要求的無鹵阻燃型覆銅板以及中,低 Df, Dk 覆銅板。建議一般常規要求添加量為樹脂固體總量的 12%~18%,若有高規要求建議以實驗決定最適添加量。

HPX-360 可以單獨添加,也可以與其它阻燃劑及無機填料並用,以獲得更高的阻燃效果和更出色的電學、機械加工、耐熱等性能。

包裝與存儲

20Kg/袋。密封儲放在乾燥、陰涼場所。